半导体组件封装激光封帽机

产品名称	半导体组件封装激光封帽机
公司名称	武汉金密激光技术有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:金密激光 型号:JM-XHY-500 适用范围:高等院校，军工企业
公司地址	东湖新技术开发区关山大道111号
联系电话	027-59212628 15927358077

产品详情

半导体组件封装激光封帽机广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境，如：锂离子电池及材料、半导体、超级电容、特种灯、激光焊接、钎焊、可伐合金、铝、铜等各种金属合金。（满GJB548B-2005检漏指标）可用于微波器件、RF封装 、T/R组件、心脏起搏器、传感器、材料合成、OLED、MOCVD等。也包括生物方面应用，如厌氧菌培养、细胞低氧培养等。

简单：严格按照德国工艺标准制造，采用7寸触摸屏操作，操作界面简单，易于上手。

安全：模块化设计，专业的无泄漏密封技术，超低泄露率≤0.001%，（行业标准≤0.050%），
严格依据标准《EJ_T1096_1999_密封箱室密封性分级及其检验方法》中的一级密封箱室验收。

高效：超低水氧≤1ppm，可达0.1ppm，进口净化材料，吸附效率高，一年再生一次，重复利用。

节能：整机功率超低，风机和真空泵智能控制。

半导体组件封装激光封帽机性能特点

1、高精度工作台，高品质手套箱，真空密封焊接。

2.不锈钢结构、抗腐蚀、易清洗、无污染。

3.观察窗视角广阔清晰明亮。

4.操作手套采用厚乳胶手套，密封可靠。

5、视觉定位,智能焊接,可精确定位跟踪焊接，保证焊接质量。

6、激光器采用国际知名品牌，保证设备质量和设备运行稳定性。

7、底板结构。结构致密、抗压强度好。

8、焊缝平整、细致、密封。

半导体组件封装激光封帽机高品质标准化激光焊接手套箱系统，满足对特定惰性气体的激光焊接应用需求。该设备采用300W-500W激光器，专用于电子器件的精密密封焊接。最大亮点在于具有智能相机视觉定位系统，分辨率高、响应时间快、编程简易。与CNC运动控制系统之间实现高效通讯，对工件的重复定位精度要求较低，可以完成任意复杂图形的高精度重复精密焊接，以区别于传统的示教编程和单一程序加工模式，可广泛应用于自动化小幅面重复精密焊接。

提供完善的售后服务，国外的技术，国内的价格，详情请电话联系

武汉金密激光技术有限公司坚持以客户为中心，为客户提供完善的咨询、试样、安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。